

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

炬芯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议		
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会		
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动		
	<input type="checkbox"/> 现场参观	<input checked="" type="checkbox"/> 电话会议		
	<input type="checkbox"/> 其他			
参与单位名称	BESTON VANTAGE FUND	国金证券	钜洲投资	信达澳亚
	Greencourt	国联基金	凯恩集团	信泰人寿
	Pinpoint	国联民生	绿色发展	兴全基金
	安中投资	国泰基金	马可孛罗至真	兴业基金
	北京泓澄	国泰君安	诺安基金	兴业证券
	北信瑞丰	国投瑞银	鹏华基金	兴银理财
	博道基金	国投证券	平安基金	幸福阶乘
	博时基金	国信证券	平安证券	晓扬科技
	财通基金	国信自营	平安资产	玄卜投资
	财通证券	果行育德	浦银安盛	循远资产
	财通资管	海富通	瀑布资产	易川资产
	长城财富	海通证券	前海富喜	易方达
	长城证券	杭州玖龙	前海锐意	永赢基金
	长江证券	浩成资产	山西证券	甬兴证券
	长信基金	红石榴	上海从容	誉辉资本
	重阳投资	泓德基金	上海方物	原点资产
	创华投资	鸿竹资产	上海瀚伦	云禧投资
	创金合信	华安证券	上海季胜	招商基金
	淳厚基金	华创证券	上海景领	招商证券
	大家资产	华创资管	上海饮沐	招银理财
	东北证券	华金证券	上海彤源	浙商证券
	东莞证券	华美国际	上海行知	中庚基金
	东吴基金	华杉投资	上海悦溪	中金公司
	东吴证券	华泰证券	上海证券	中金资管
	东兴基金	华西证券	申万宏源	中略投资
	富国基金	华夏复利	神农投资	中泰证券
	工银瑞信	华夏基金(香港)	世纪前沿	中信保诚
	光大保德信	汇金并购	太平养老	中信建投

	广东正圆	汇泉基金	泰康资产	中信证券	
	广发证券	基明资产	泰信基金	中信资管	
	广发资管	嘉实基金	彤源投资	中银证券	
	广西深圳 产业合作中心	建信资产	西部利得	中邮证券	
	国海证券	金科投资	西藏信托	中原证券	
	国华兴益	金信基金	西南证券	珠海鲸芯	
	国金基金	景泰利丰	橡果资产		
会议时间	2025 年 02 月 11 日—04 月 24 日				
会议地点	线上会议；公司会议室				
上市公司	董事长、总经理：周正宇				
接待人员	董事会秘书：XIE MEI QIN				
姓名	证券事务代表：程奔驰				
投资者关 系活动主 要内容介 绍	经营情况简介				
	<p>2024 年度，公司积极拥抱端侧产品 AI 化的进程，持续投入技术研发并高度重视市场拓展工作。报告期内，公司产品表现亮眼，销售收入与净利润稳健快速增长。其中，端侧 AI 处理器芯片凭借低功耗、高算力的优势，出货量不断攀升，销售收入实现倍数增长；低延迟高音质无线音频产品持续放量，销售额持续上扬；蓝牙音箱 SoC 芯片持续加大在头部品牌客户的渗透力度，不断深化公司与客户合作的广度和深度。</p>				
	<p>2024 年，公司实现营业收入 6.52 亿元，同比增长 25.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.06 亿元，同比增长 63.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7855.39 万元，同比增长 53.65%。报告期内，公司研发投入合计 2.15 亿元，同比增长 30.06%，公司完成了 CPU+DSP+NPU 三核异构核心架构的研发，发布了第一代三核架构芯片，基于 SRAM 的模数混合存内计算技术，打造了低功耗大算力的端侧 AI 芯片平台；同时，公司高度重视构筑端侧 AI 开发生态环境的建设，发布了 ANDT 开发工具链，具有良好的兼容性、丰富的算子库，可以有效提升客户 AI 模型的部署效率，不断拓展产品的应用边界。</p>				
	<p>Q1：2024 年营收增速较高的产品是哪些？</p> <p>答：公司增速较快的是蓝牙音箱 SoC 芯片、低延迟高音质无线音频 SoC 芯</p>				

片和端侧 AI 处理器芯片产品。其中：在蓝牙音箱市场，公司国际一线品牌持续提升渗透率，获得了稳健的增长；在低延迟高音质无线音频芯片市场，公司把握无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线麦克风市场有线转无线化的趋势，取得了同比显著增长；在端侧 AI 处理器市场，公司突出在低功耗下提供大算力的特点，为客户提供优秀的解决方案，产品出货量实现倍数提升。

Q2：公司发布了今年一季度业绩预告，盈利水平和盈利能力同环比的表现都超出了市场的预期，请问原因是什么，怎么展望这个趋势？

答：公司发布了 2025 年第一季度业绩预告，预计实现营业收入约为 1.91 亿元，同比增加 61.23%，实现归母净利润约为 4130 万，同比增加 383.91%，实现扣非归母净利润约为 3850 万元，同比增加 603.90%。从消费电子行业的历史数据看，第一季度通常为淡季，第二、三季度通常会是旺季。今年公司第一季度的业绩表现亮眼，主要是来自于深耕客户市场产品销售结构不断优化、投入研发持续提升产品竞争力所带来的持续增长。

Q3：美国关税政策的影响如何判断，公司有直接向美国本土出口芯片么？

答：根据公司芯片下游应用场景、客户地域以及最终消费者分布情况分析，美国关税政策对于公司的直接影响较小。首先，公司芯片的销售模式主要为客户下单后，交付给指定加工厂或 ODM 厂商，最终集成在 AIoT 终端产品后整机进行销售，并未直接对美国出口芯片，且通常情况下，SoC 芯片供应商除了提供芯片，还为客户提供融合软硬件和算法的整体解决方案，品牌客户在选定芯片供应商后不会轻易发生变动，具有较强的客户粘性，据了解 ODM 厂商和加工厂也在全球范围布局了产能产线。其次，公司客户来自中国大陆、欧洲、日本、韩国、新加坡、北美、澳大利亚、印度等区域，客户地域分布上呈现多元化，以哈曼和 Bose 为代表的美国本土品牌客户亦是面向全球消费电子市场进行销售，AIoT 终端消费者在地区分布上较为均衡，且在消费电子领域，关税价格通常由进口商承担，价格传导机制上对于消费电子供应链企业影响有限。最后，公司已与下游客户、ODM 厂商进行了充分沟通准备，从供应链安全角度做好了相应预案措施，相互协同以应对关税政策带来的不确定性影响。

Q4：公司去年底正式发布了第一代三核架构的芯片产品，目前客户导入的进展如何？

答：公司已正式发布最新一代基于 SRAM 的模数混合存内计算的端侧 AI 音频芯片，采用 CPU+DSP+NPU 三核异构架构，可在更低功耗下提供更高算力，同时兼具更低的延迟和增强的安全性，将在音频应用和端侧 AI 中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列：第一个系列是 ATS323X，面向低延迟高音质私有无线音频领域；第二个系列是 ATS286X，面向蓝牙 AI 音频领域；第三个系列是 ATS362X，面向端侧 AI 处理器领域。目前部分品牌客户已进入量产阶段，近期已有客户终端产品发布上市。

Q5：如何展望今年新产品贡献营收的趋势，对于公司 ASP 拉动的影响？

答：公司基于三核异构架构的芯片采用了更加先进的工艺制程，相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，而相较于市场上主流的 NPU 产品能效比可以提升至少三倍以上，相较于主流的 DSP 产品在功耗方面能降低接近 90%，因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升，今年新产品将对营收以及 ASP 持续产生正向拉动。

Q6：公司对于收并购的方向和规划是什么？

答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

Q7：三核架构除了对当前的场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？

答：在基于 SRAM 的模数混合存内计算技术路径下的端侧 AI 音频芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧 AI 解决方案的快速落地。公司也将积极打造 AI 开发生态，借助炬芯完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，积极助力 AIoT 产品 AI 化的不断演进。

Q8：接下来一段时间，研发投入的方向以及相关人员费用的规划是什么？

答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，公司很高兴看到技术研发投

入与营收规模提升保持着正向循环，2024 年公司研发支出 2.15 亿元，占营收比例约 33%，公司主要取得了三个方面研发成果，第一是基于 CIM 技术打造了炬芯第一代三核异构架构的芯片平台，第二是发布了 ANDT 开发工具链，可以助力客户模型的快速部署，打造端侧 AI 高效开发生态环境，第三是持续升级拓展无线连接技术，低延迟高音质各项指标达到了业界先进水平。接下来一段时间，公司的研发投入方向也将继续围绕低功耗大算力、开发生态和无线连接三个方向拥抱端侧 AI 海量的芯片需求。

Q9：公司存算技术后续的路线迭代是什么计划？

答：在存内计算（CIM）技术迭代上，尤其是关键性能指标等方面，公司有着清晰的路线规划，目前已着手第二代 CIM 技术的相关 IP 研发工作，目标是将 NPU 单核算力提升三倍至 300GOPS，并直接支持 Transformer 模型，将能效比提高至 7.8TOPS/W @INT8。

Q10：公司产品在端侧 AI 落地的场景以及后续对于端侧 AI 市场的规划？

答：公司的端侧 AI 处理器芯片当前优先应用在音频市场，相应的场景包括人声分离、AI 智能降噪等，公司发挥自身的技术优势，可以为端侧产品提供低功耗下的 AI 算力。公司会持续打造低功耗的 AI 算力平台，将逐步拓展至音频之外的更多应用场景，比如运动健康方面的传感器数据 AI 处理应用等。

Q11：看到公司公众号推送了客户 Halliday AI 眼镜的相关资讯，目前是否有其他的眼镜客户在对接导入？

答：公司作为 Halliday AI 眼镜的智能穿戴芯片提供商，为 AI 应用提供了低功耗大算力的高性能硬件基础，为用户带来了超长的续航，流畅丝滑的操作体验，助力产品成功上市。由于商业保密条款约束，公司暂无法提供其他客户在研 AI 眼镜项目的进展情况。

Q12：针对 AI 眼镜、智能手表等智能穿戴类芯片会有新的芯片产品推出么？

答：目前公司相关研发工作正在稳步推进中，新一代智能穿戴芯片将采用三核架构，搭载存内计算技术，将为下游客户提供更具竞争力的芯片平台与产品解决方案。

是否涉及 应当披露 重大信息 的说明	不涉及
附件清单 (如有)	无
日期	2025年04月25日